

RELATÓRIO DE NPI

FR455

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CÓD. PRODUTO: 578278 DESCRIÇÃO: test

CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI							
QTDE NPI: 2782	DATA: 2022-11-17						
APRESENTAÇÃO DO N	IPI						
Aplicação do Produto: Classe (IPC-A-610):							
ocumentação está Ok : SIM Falta o documento de:							
Qual cód.?							
Origem do Stencil? Data de chegada: 2022-11-17							
ente? SIM Quant. Etiquetas:							
Instr. de Montagem Especial? SIM							
Etapas produtivas:							
☐ Teste	□ OBA						
☐ ICT	Certificado de Qualidade						
☐ Gravação	Registro de Histórico do Produto						
☐ Outros							
Ações de melhoria:							
ação ☐ painelizar PCI	✓ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)						
Comentários quanto a apresentação do novo produto: cfescf							
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO							
Organizador (Eng. de Produto): Ana Paula Jahnz Data: 2022-11-17							
Participantes:							
	Eng. de Teste: Fernando Borges						
	Eng. de Teste: Fernando Borges Comercial: Ana Carla Mendes						
	APRESENTAÇÃO DO N Classe (IPC-A-610): Falta o documento o Qual cód.? Data de chegada: 20 Quant. Etiquetas: Instr. de Montagem I Etapas produtivas: Teste ICT Gravação Produtos Químic Ações de melhoria: Ção painelizar PCI o: cfescf REUNIÃO DE APRESENTA						

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO				
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-17				
Atividade: Separação de materiais no almoxarifado				
▼ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?				
✓ Algum componente será montado sob desvio?				
Comentários quanto a apresentação do novo produto: test				
MONTAGEM SMT				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT				
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-17				
Atividade: Printer				
Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Tipo de insumo aplicado?				
Tipo de apoio utilizado na Printer?				
Inspeção por SPI? □				
Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Atividade: Inserção automática				
Em qual linha foi realizado o NPI?				
Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Atividade: Reflow e Inspeção				
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? □				
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:				

Realizado inspeção visual?				
Utilizado Raio-X? * □				
Atividade: Router				
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? BASE	ldentificado algum problema ou oportunidade de melhoria? □			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM S	SMT (RUN10)			
Responsável : Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-17			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONT	TAGEM SMT			
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 1 : xqdq Ok	xxzdq			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: xzqdzq				
Houve problemas críticos?				
Gerado documento devido a problemas?				
Verificação da Montagem SMT APROVADO				
Validado por: Nilson Ishikawa	Junto com: Nilson Ishikawa			
MONTAGEM THT/LEA	N .			
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM	THT/LEAN			
Responsável: Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-17			
Atividade: Pré forma				
Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo? $\hfill\Box$				
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				
Atividade: Cablagem				
Todos os cabos contêm suas especificações? □				
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?				

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador? ☐
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐
Atividade: Pré compor
Houve alguma dificuldade na depainelização? □
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
Atividade: Compor
Foi identificado algum problema durante a montagem? □
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo? □
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
Atividade: Soldar PTH/Inspeção
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem? ☐
A atividade de Touch up será necessário? □
O layout da placa facilita a operação de ressolda? □
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final
Todos os componentes contêm suas especificações? □
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador? ☐
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

Existe a aplicação de verniz no produto?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐				
VERIF	ICAÇÃO DA MONTA	AGEM THT/L	ean (RUN10)	
Responsável: Wajdi Ben Helal			Data:	
VERIF	FICAÇÃO PARCIAL	- MONTAGE	M THT/LEAN	
Seq. de Placas (número de série) OK/FAI	LHA		Descrição da Falha	
Placa 1 : xqdq Ok				
Comentários técnicos e Análise crítica referente a M	∕lontagem THT/Lear	n: xzqdqzxd		
Houve problemas críticos? 1				
Gerado documento devido a problemas? ✓			Doc.:	
APROVADO Verificação da Montagem THT/Lean				
Validado por: Nilson Ishikawa			Junto com: Nilson Ishikawa	
	TES	TES		
Run10 nº.:				
	EXECUÇÃO	DO TESTE		
Responsável: Wajdi Ben Helal			Data:	
	EXECUÇÃO	DO TESTE		
Qual tipo de teste é realizado?				
Testes/Jiga desenvolvido por?				
☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?				
☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?				
✓ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				
RESULTADOS DO TESTE				
Responsável : Wajdi Ben Helal			Data: 2022-11-17	
VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE				
Seq. de Placas (número de série) OK/FAI	LHA		Descrição da Falha	
Placa 1 : xqdq Ok				

Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: xdzqx

	AGE	- 8.4
ΙНΔΙ	Δ(-1	-IVI

Run10 nº.:

Responsável: Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-17

Atividade: Embalagem

☐ Embalagem é pertencente ao

Cliente?

☐ Há necessidade de etiqueta

ESD?

Comentários técnicos referente a etapa de

Embalagem:

Qual tipo de embalagem será utilizado?

Como a embalagem será fechada?

REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Data: 2022-11-17 Organizador (Eng. da Qualidade): Ana Paula Jahnz

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Anna Paulla da Rocha

Eng. de Teste: ADRIANA FERREIRA

Eng. de Processo SMT: Aroilde Istailer Barbosa Souza

PCPM: Adriana F. de Lima Jeremias

Eng. de Produto: ADRIANA FERREIRA

Outros: Adriana F. de Lima Jeremias

ANÁLISE CRÍTICA:

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)

Wajdi Ben Helal

Data hora enviar : 2022-11-17 15:00:2 Data hora aprovada : 2022-11-17 15:01

PARECER FINAL STATUS

APROVADO

Com restrições? SIM

Implementação de: xdzqd

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de

mudanças)

Wajdi Ben Helal

Data hora enviar: 2022-11 Data hora aprovada : 2022

Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM